

熱を加えると軟化・溶融し、密着性が向上。

状態変化材料 スペシャル・フェイズチェンジ熱伝導シート

【特長】

●CPU・GPU・パワー半導体等の発熱部品とヒートシンク、CPUクーラー等の放熱部品の間に挟み、熱抵抗を低減する為の熱伝導材料です。常温では固体ですが、熱を加えると軟化・溶融し、部品表面の微細な凹凸を埋め、密着性を向上させます。

●常温ではシート状で取り扱いやすい。

所定の形状にてCPU・GPU・パワー半導体等の発熱部品の上に載せるだけで使用できます。

●加熱されると軟化・溶融し、接触面に密着します。

45℃から固体が軟化し、半液状化(ゲル状)し、優れた濡れ性を備えます。

CPU・GPU・パワー半導体等の発熱体が動作し温度が上がると、シートが軟化・半液状化し、発熱体の微細な凹凸や隙間を埋め、密着性が向上します。

●非常に薄い熱界面層を形成。

圧着後の厚さを非常に薄くできますので、放熱性能に影響を与える熱抵抗を低くすることができます。

●塗布量のばらつきが少ない。

シートは厚みが管理されておりますので、グリスのような「塗り過ぎ」「塗り不足」「塗布ムラ」が起こりにくく、量産時の作業性や品質の安定に適しています。

●長期信頼性があります。

従来のグリスで発生するポンプアウトが起こりにくく、高い信頼性があります。

●シリコンフリー

シリコンを含まない為、低分子シロキサンによる接点障害を引き起こしません。

●絶縁性、RoHS2.0に準拠

【仕様】

型番：WW-PCM095-35 JAN：4524945014176

項目	単位	値	試験基準
サイズ	mm	35×35	—
厚さ	mm	0.25	ASTM D374
熱伝導率	W/m・K	9.5	ASTM D5470
色	—	グレー	—
相変化温度	℃	45	—
密度	g/cm ³	2.55	ASTM D792
使用温度範囲	℃	-50～140	—
熱抵抗値 @10psi	℃・in ² /W	0.0173	ASTM D5470
熱抵抗値 @30psi	℃・in ² /W	0.0063	ASTM D5470
熱抵抗値 @50psi	℃・in ² /W	0.0057	ASTM D5470

【製品画像】



【使用方法】

①CPU・GPU・半導体・ヒートシンク等の接触表面を清掃して下さい。表面の油分・ホコリ等除去して下さい。

②シート片面の保護フィルムを外して、発熱体の上に配置・貼り付けて下さい。

③配置・貼り付けた後、もう片面の保護フィルムを外して下さい。

④CPUクーラー、ヒートシンク等の放熱部品を設置して下さい。

⑤機器を動作させ、熱を加え相変化温度まで上げ、馴染ませて下さい。

⑥軟化したシートが表面の凹凸を埋め、最適な密着状態となります。

※一度使用しますと、形状は変化している為、再利用はしないで下さい。

【問合せ先】

株式会社ワイドワーク

TEL：03-5818-7532

FAX：03-5818-7533

mail：sato@widework.co.jp